Назва конференції: **V всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників**

**«Інженерія поверхні та зварювання. Комплексний підхід»**

Останній термін подачі тез – 10 грудня 2018 р. Дата проведення конференції – 11 грудня 2018 р.

Секції:

1. Фізико-хімічні основи інженерії поверхні.
2. Функціональні покриття та поверхні.
3. Споріднені процеси в інженерії поверхні.
4. Основи педагогіки вищої школи

**Вимоги до оформлення тез**:

Поля: верхнє/нижнє/ліве – 20м мм, праве – 10 мм.

Шрифт **Times New Roman,** розмір 14, одинарний міжрядковий інтервал, абзац 1.25

**Порядок подання інформації:**

У перших рядках з вирівнюванням по центру **напівжирним** шрифтом дається назва тез **прописними літерами** (без крапки в кінці). Назва тез повинна містити не більше 9 слів.

З нового рядка *курсивом* по центру дається перелік авторів та співавторів, де обов’язково вказується науковий ступінь (при наявності) або посада (інженер, студент, аспірант тощо) та місце роботи автора (-ів) у дужках.

Далі іде текст тез, з вирівнюванням по ширині.

Назва та автори можуть займати більше одного рядка.

**Об’єм тез** –дві або більше повні сторінки.

**Формули** друкуються в редакторі формул – Редактор формул Word **“Уравнение”\*.**

Усі тези проходять обов’язкове внутрішнє рецензування, за результатами якого авторам може бути відмовлено у публікації.

Тези надсилайте на e-mail: Schweiser1@gmail.com

\* Редактор формул **Microsoft Equation** більше не доступний після оновлень програмного забезпечення Microsoft Office.

Приклад оформлення тез:

**Назва**

*І.П. Прізвище, посада (Заклад)*

За емпіричними формулами, запропонованими Нііхара:

$\left(\frac{H}{EФ}\right)^{0,4}\left(\frac{K\_{I\_{c}}Ф}{Р\sqrt{а}}\right)=0,035\left(\frac{l}{a}\right)^{-^{1}/\_{2}}$, (1)

де *H* – твердість; *Е* – модуль Юнга; *Ф*– коефіцієнт (може змінюватись в межах від 1,8 до 3,0); *а* – напівдіагональ відбитку індентора Віккерса; *с* – половина довжини тріщини; *l = c*– *a -*  довжина тріщини Палмквіста.

Які характеризують адгезійні властивості системи «основа – покриття» (див. табл. 1).

Таблиця - 1. Електрофізичні властивості системи “основа–плазмове покриття”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Покриття | Al | AlNi | Mo |
| Питомий електроопір покриття *ρП*·103, Ом$∙$мм | 3,2 | 15,0 | 17,8 |
| Електроопір контактної зони *RK*·105, Ом | 5,83 | 4,5 | 1,1 |